

2011年10月31日

各位

「ハイウェイテクノフェア 2011」に出展致しました

拝啓

貴社ますますご隆盛のことと、お喜び申し上げます。平素は格段のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日はご多忙のなか、当社の展示ブースにご来場いただき誠にありがとうございました。おかげさまで盛況のうちに終了することができました。会場におきまして当方の対応や説明に行き届かぬ点があったとは存じますが、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。今後とも皆様のご要望にお応えすべく、さらなる製品開発・技術開発への努力を致しますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが、今後ますますの皆様のご発展とご活躍を祈念いたしまして、簡単ではございますが、ご来場のお礼とさせていただきます。

敬具

記

当社展示ブースでは、下記に示す技術・製品をご紹介させていただきました。内容につきまして、ご不明な点等ございましたら、何なりとご連絡いただければと存じます。

事業部名	技術・製品
ファスナー事業部	せん断補強 RMA 工法, 緩み止め技術
建設事業部	RDN 工法, ShieM-CS 工法, SR-LG 工法
土木資材事業部	ハイパネルシグナルシート, RPE ロックボルト
技術部	直貼り PV シート, 透光性遮音壁のリニューアル, LED 照明

《展示会 写真》

